



2020年9月18日

各 位

会 社 名 株式会社岡本工作機械製作所  
代表者名 取締役社長 石井 常路  
(コード番号 6125 東証 第二部)  
問合せ先 総務部長 小河 恵資  
(TEL. 027-385-5800)

## 「研究成果最適展開支援プログラム」開発期間延長について

当社半導体関連装置開発部門において、実用化を目指して研究開発を進めておりました「Si 貫通電極ウェーハ全自動薄化加工装置」の計画につきまして、JST から支援を受ける開発期間が延長される事となりましたので、お知らせいたします。

記

### 1. 「研究成果最適展開支援プログラム」の目的

当該事業は、大学・公的研究機関等で生まれた国民経済上重要な科学技術に関する研究成果を基に、実用化を目指す研究開発フェーズを対象とした国立研究開発法人科学技術振興機関が実施する技術移転支援プログラムです。

### 2. 採択された課題

(1) 課題名

「Si 貫通電極ウェーハ全自動薄化加工装置」

(2) 課題の概要

開発テーマは Si 貫通電極(TSV)ウェーハを高平坦かつ高均一に 10 $\mu$ m-50 $\mu$ m 厚さレベルまで薄層化する加工技術です。新たに開発した自動 Si 厚さ補正機構付き研削盤、Si/Cu 同時研削技術、および金属汚染低減化技術を融合した TSV ウェーハ全自動薄化加工装置を世界で初めて実用化します。

(3) 開発期間(予定)

全体課題完了を 2023 年5月とする。

### 3. 今後の見通し

今後の業績に与える影響は現時点では不明であり、開示が必要な場合には、改めてお知らせ致します。

以上